# 目录

一、生	注活中的电力电子设备: 手机电源适配器	1
1.1	电源适配器定义	1
1.2	设备简介	1
1.3	设备电路及功能分析	1
1.4	电路分析	2
1.5	器件型号及其参数	3
二、电	上力 MOSFET 仿真特性及比较	4
2.1	输出特性	4
2.2	漏一源极导通电阻	5
2.3	转移特性	6
2.4	反向二极管的正向特性	7

# 一、 生活中的电力电子设备: 手机电源适配器

# 1.1 电源适配器定义

电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,也包括我们平时所说的"充电插头",一般由外壳、变压器、电感、电容、控制 IC、PCB 板等元器件组成。它的工作原理是将交流输入转换为直流输出,将家用交流电转换为较小电压的直流电用于手机充电,拥有过压、流保护、短路保护等,确保使用者的安全

# 1.2 设备简介

本次选择的电力电子设备为飞天鹰 PS05L 便携适配器,能效等级为六级。



图 1: 产品参数

# 1.3 设备电路及功能分析

经查阅资料和小组讨论,电源适配器中电压变换过程可以简要表示为图 2。

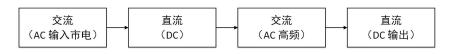


图 2: 电源变换过程

在广泛查阅资料后,我们可以得到适配器内部电路图为图 3。

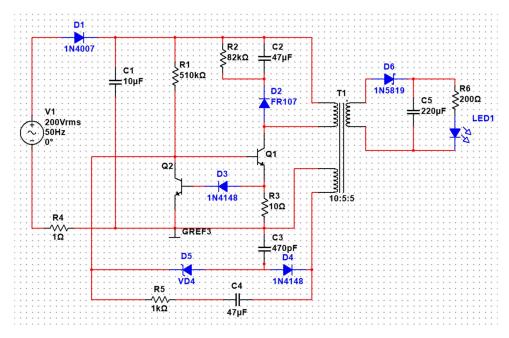


图 3: 电路图

以主电路、控制电路、驱动电路等为分类标准,确定此电源适配器电路总体可分为三个部分。具体划分如图 4。

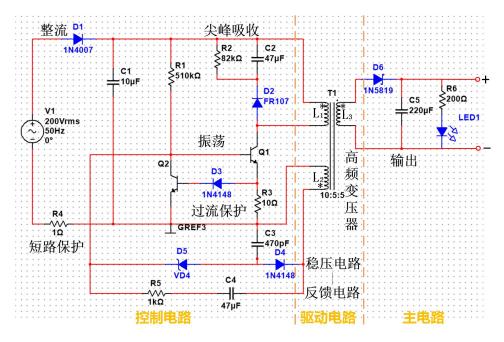


图 4: 电路划分图

# 1.4 电路分析

经小组拆解及研讨,以功能作为分类标准,电路可以分为整流滤波电路,震荡电路,保护电路 以及稳压电路。具体划分见图 4。

#### 1)整流滤波电路

D1、C1 半波整流, 二极管 D1 将输入的 220V 交流电压转化为峰值电压为 311V 的脉动直流电压, 再由电容器 C1, 将脉动直流电压滤波达到 300V 左右的直流电压。

R2、C2、D2 吸收尖峰, R2、C2 组成高频滤波器, 吸收频率较低的尖峰, 将电源转为高频交流 电再由 D2 整流。D6、C5, 将振荡变压所得的交流高频电压转换为直流电压输出。

# 2) 振荡电路

 $R_1$ 、Q1、L1、L2、C4、R5 形成正反馈,如果没有 L2、C4、R5 反馈支路的存在,三极管 Q1 就只能通过偏置电阻  $R_1$  提供合适的偏压,形成了一般的放大电路。

## 3)保护电路

D3,采用 1N4148 防止电压过大导致电流过大烧损适配器。

# 4) 稳压电路

D4, 控制 L2 两端电压, 确保被高频变压器转换后为所需电压值。

# 1.5 器件型号及其参数

符号	说明	单位
$\overline{}V_F$	最大正向电压	$\overline{V}$
$T_{ m max}$	最高工作温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
$T_{ m min}$	最低工作温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
$I_{OM}$	最大输出电流	A
$V_P$	最大重复峰值反向电压	V
$I_F$	最大重复峰值正向电流	A
$I_C$	最大集电极电流	A
$h_{FE}$	最小直流电流增益	/
$V_{CBO}$	集电极发射极最大电压	V
$V_{CEO}$	集电极发射极击穿电压	V

表 1: 符号说明

型号	$V_F$	$T_{\rm max}$	$T_{\min}$	$I_{OM}$	$V_P$	$I_F$
1N4007 (D1)	1.1	150	-55	1	1000	30
$FR_107 (D2)$	1.3	175	/	1	1000	30
1N4148 (D3,D4)	1.0	125	-65	0.15	1000	30
1N5819 (D5)	0.9	150	-55	1	40	25

表 2: 整流二极管型号及参数

型号	$I_C$	$h_{FE}$	$T_{ m max}$	$T_{\min}$	$V_{CBO}$	$V_{CEO}$
ST13003 (Q1) C945(Q2)		5 130	150 150	-40 -55		400 50

表 3: 双极晶体管信号及参数

# 二、 电力 MOSFET 仿真特性及比较

本组对应器件编号为: MOSFET-Infineon-BSC440N10NS3-DS-v02 04-en

# 2.1 输出特性

# 1) 仿真结果

对应的 LTspice 仿真测试电路及结果如下,设置  $V_{DS}$  从 0V 至 3V,取 0.001 分度;  $V_{GS}$  取 4.5V 至 10V,取 0.5 分度,以  $R_1$  模拟导线等电阻:

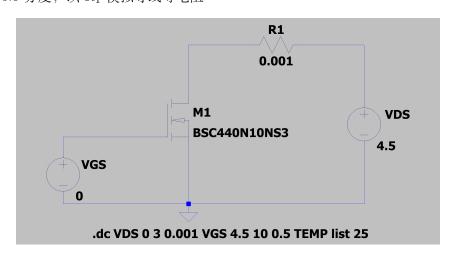


图 5: 输出特性仿真电路图

#### 2)结果分析

由于  $V_{GS}$  范围设置为 4.5-10,大于  $V_T(2\text{-}4V)$ ,因此不存在截止区。当  $V_{DS}$  不足够大时(未达到饱和区),在可变电阻区,栅源电压  $V_{GS}$  用来改变沟道宽窄, $V_{DS}$  电压使沟道产生梯度,随着  $V_{DS}$  增大,梯度越来越大,最终形成点夹断, $I_D$  达到饱和,这时  $I_D$  由  $V_{GS}$  唯一控制。因此,当  $V_{GS}$  固定时,随着  $V_{DS}$  的增加, $I_D$  先升高,然后变平。当  $V_{DS}$  固定时,随着  $V_{GS}$  的增加, $V_{DS}$  的过程, $V_{$ 

比较仿真图像与手册给出特性,输入特性图像变化趋势几乎相同,具体数据不同,经小组讨论分析,认为有以下两点原因:

1. 仿真结温与实际结温有差别。在仿真模拟中, MOSFET 温度被定为恒定的 25 度, 而在实际操作中, 场效应管温度不可能保持温度一致, 进而导致曲线的不一致。

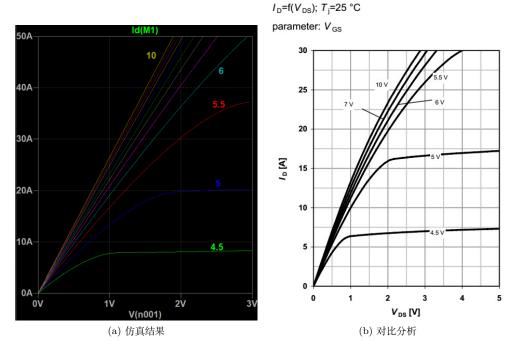


图 6: 输出特性结果及对比

2. 电路中电阻  $R_1$  的取值也会影响结果。

# 2.2 漏-源极导通电阻

# 1) 仿真结果

应用仿真模拟,其电路搭接与 2.1.1 中输出特性一致,设置  $V_{DS}$  从 0V 至 150V,0.001 分度;  $V_{GS}$  从 5V 至 10V;温度设置为 25 度和 150 度:

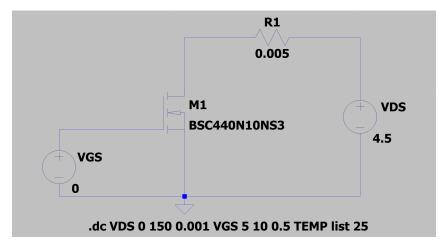


图 7: 导通电阻仿真电路图

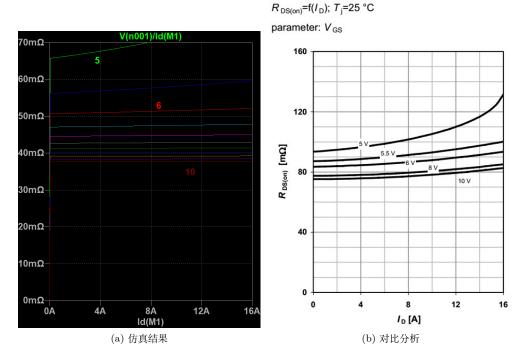


图 8: 输出特性结果及对比

## 2) 仿真结果分析

随着  $V_{DS}$  的增加,其近似为漏—源极导通电阻两端电压,由 图 6a 输出特性曲线可知, $I_D$  先增大后平稳。由  $R_{DS} = V_{DS}/I_D - R_1$  可知,当  $V_{DS}$  增大时,分子还在增大,总体上升。特别是当  $V_{DS}$  增加到足够大,使  $I_D$  趋于饱和,由于自变量为  $I_D$ ,故漏—源极导通电阻直线上升。

# 2.3 转移特性

# 1) 仿真结果

仿真转移特性的相应电路图与前文电路相同,其仿真结果如图 9 和图 10 所示。

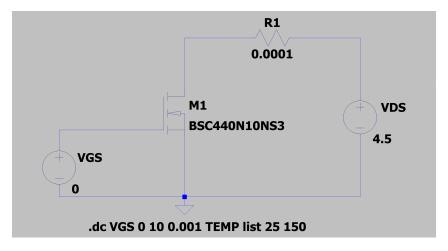


图 9: 转移特性仿真图像

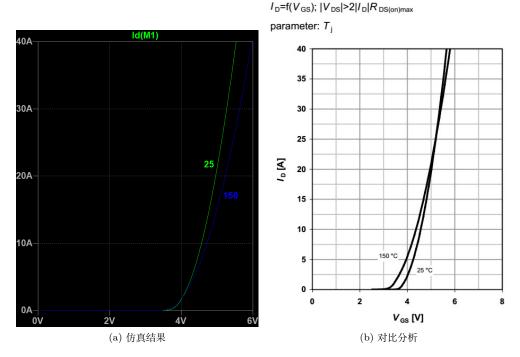


图 10: 输出特性结果及对比

# 2) 仿真结果分析

图中,当  $V_{GS}$  大于导通电压 VT 时 (图中为 3V 左右),MOSFET 接通,产生漏极电流  $I_D$ 。由上述输出特性已知, $V_{GS}$  越大,导电性越强,电流越大。同时,在 150°C 时,电流更大。但通态电阻的温度系数为正(随温度升高,阻值会变大),所以当  $V_{GS}$  逐渐增大时,在 25°C 时  $I_D$  会增大的更快。

观察两幅图形,均有线路交叠。当  $V_{GS}$  大于导通电压 VT 时 (图中为 3V 左右),MOSFET 接通,产生漏极电流  $I_D$ ,  $V_{GS}$  越大,导电性越强,电流越大。首先,在  $150^{\circ}$ C 时,电流更大。但通态电阻的温度系数为正,所以当  $V_{GS}$  逐渐增大时,在  $25^{\circ}$ C 时  $I_D$  会增大。

## 2.4 反向二极管的正向特性

#### 1) 仿真结果

如图 11 所示,为测试 MOSFET 的二极管反向导通特性,只连接漏级和源级,令栅极悬空,电路可等效为漏级和源级之间加了一个反向二极管,此时加反向电压  $V_{SD}$ ,即可反映反向二极管的正向导通特性。

#### 2) 仿真结果分析

如图 12 所示,在图 12a 中,随着温度从 25 度上升到 150 度,特性曲线左移。且电路中加反向电压,由于体二极管的存在,反向电压只要大于这个体二极管的死区电压是可以导通的。此图像与

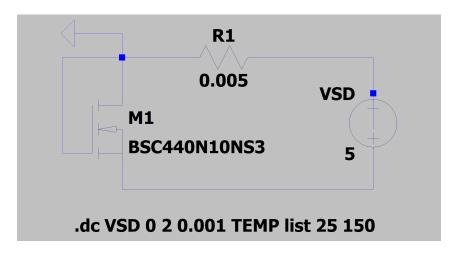


图 11: 反向二极管的正向特性仿真图像

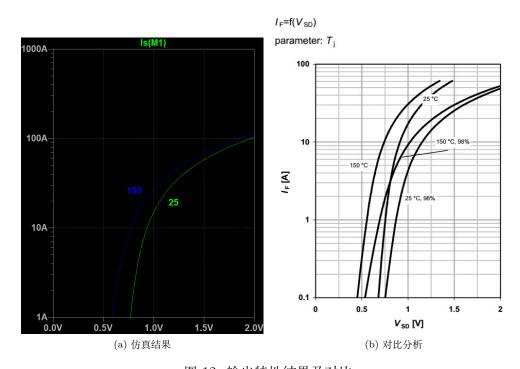


图 12: 输出特性结果及对比

一般二极管一致。

# 2.5 开关波形

# 1) 仿真结果

如下图所示搭建电力 MOSFET 测试仿真电路,其中由于电源内阻  $R_s$ 、漏极电流检测  $R_f$  较小,在电路中仅取  $1\Omega$ ,在  $V_{GS}$  加入脉冲信号,我们可以得到相应的开关波形。

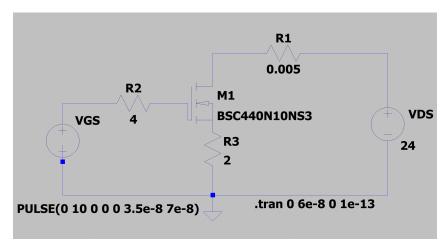


图 13: 开关波形仿真电路图

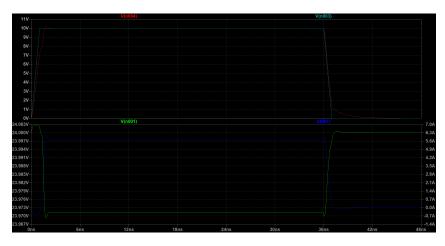


图 14: 开关波形仿真电路图

# 2) 仿真结果分析

如图 14 所示,与预期曲线基本一致,形成了上升阶段的"密勒平台",同时仿真中由于所加电阻及元件寄生电容等原因,曲线存在波动。

由于电力 MOSFET 存在输入电容  $C_{in}$ ,其有充电过程,使门电压  $U_{GS}$  呈指数级上升。当  $U_{GS}$  上升到导通电压  $U_T$  时,漏极电流  $I_D$  开始出现,之后随着  $U_{GS}$  的上升, $I_D$  上升到一个稳定值时,栅电压上升到  $U_{GSP}$ ,漏极电压  $U_{DS}$  开始下降。在漏极电压降时,栅极电压  $U_{GS}$  将维持  $U_{GSP}$  的值,形成平台。它不会继续上升到它的稳态值,直到结束电压下降,最终形成了"密勒平台"。